

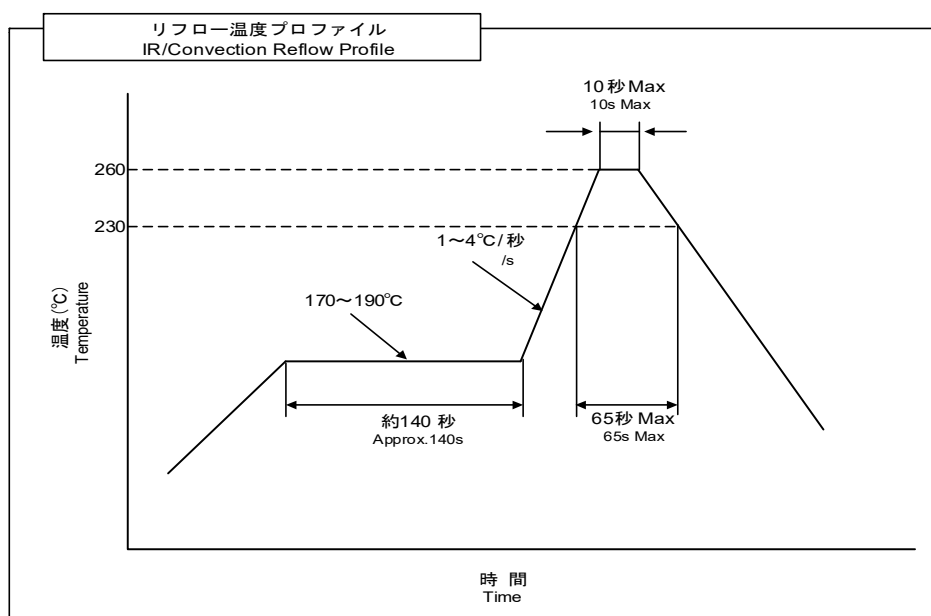
【パッケージ / Package : LGA-6B01】

| シリーズ名 Series Name | 製品質量 (mg) Product Mass (mg) | MSL | リフロー Reflow ※ | フロー Flow | 手はんだ Manual ※ |
|----------------------|--------------------------------|-----|------------------|------------------------|------------------|
| XC9281 | 1.2 | 1 | 可 available | 不可 not available | 可 available |
| XC9282 | | | | | |

※ はんだ付け条件 (以下の条件の範囲内でご使用下さい)

Soldering Conditions (please use within the following conditions.)

1) リフローはんだ(3回) / Reflow Soldering Temperature Profile (three times)



2) 手はんだ(2回) / Manual Soldering (twice)

こて先温度 400°C以下 時間 3秒以内 / Bit Temperature: Under 400°C Time: Under 3s